

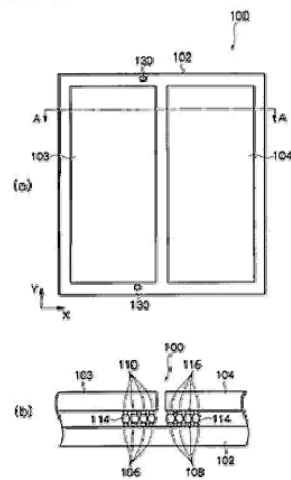
- 株式会社リキッド・デザイン・システムズの特許 - 2つの構造特許を紹介

## 3次元実装構造の bumps 接続特許

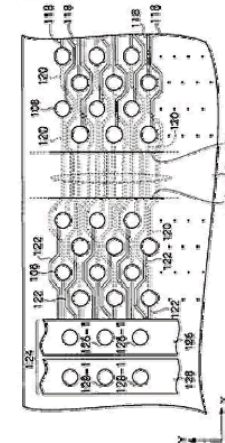
### 特許3887656号

2つの異なるチップ間を千鳥状にマイクロ bumps により接合する  
千鳥 bumps 構造の特許

【図 1】



【図 2】



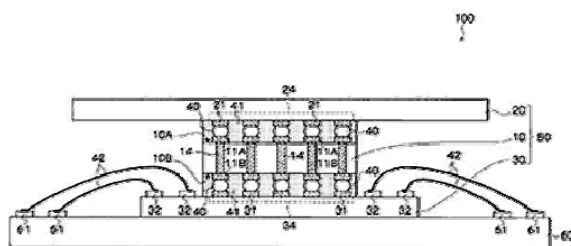
LIQUID

## 3次元実装の両面実装特許

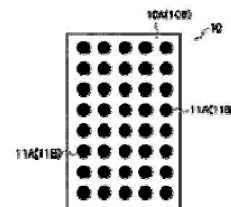
### 特許3895756号

シリコンインター・ポーザに貫通電極を有し、両面にチップを実装し、シリコン  
インター・ポーザを最短距離で結線する構造の特許

【図 1】



【図 2】



LIQUID